

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【公開番号】特開2004-179677(P2004-179677A)

【公開日】平成16年6月24日(2004.6.24)

【年通号数】公開・登録公報2004-024

【出願番号】特願2004-25535(P2004-25535)

【国際特許分類第7版】

H 0 1 L 23/12

H 0 1 L 21/60

【F I】

H 0 1 L 23/12 5 0 1 F

H 0 1 L 21/60 3 2 1 V

【手続補正書】

【提出日】平成16年11月24日(2004.11.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

一主面に複数本のインナリードが敷設されたキャリアに半導体チップが絶縁膜を介して機械的に接続されているとともに、この半導体チップの各電極パッドが前記各インナリードにボンディングされている半導体集積回路装置の製造方法であって、

前記ボンディングに際して、前記インナリードの一部がボンディング工具の先端部によってインナリードの中間部分を押されることにより弯曲されるとともに、前記インナリードの先端部分を前記電極パッドに対応する位置に移動させ、前記ボンディング工具によって前記電極パッドに押し付けられてボンディングされることを特徴とする半導体集積回路装置の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

すなわち、一主面に複数本のインナリードが敷設されたキャリアに半導体チップが絶縁膜を介して機械的に接続されているとともに、この半導体チップの各電極パッドが前記各インナリードにボンディングされている半導体集積回路装置の製造方法であって、

前記ボンディングに際して、前記インナリードの一部がボンディング工具の先端部によってインナリードの中間部分を押されることにより弯曲されるとともに、前記インナリードの先端部分を前記電極パッドに対応する位置に移動させ、前記ボンディング工具によって前記電極パッドに押し付けられてボンディングされることを特徴とする。